



京鼎精密科技股份有限公司

2024第一季法人說明會

2024/05/29

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

會議議程

- 公司簡介
- 財務報告
- 營運與展望
- 問答交流

李貞誼

發言人

鄒永芳

財務長

邱耀銓

總經理

鄒永芳

財務長

李貞誼

發言人

陳鎮福

特 助

黃俊凱

協 理

徐朝煌

協 理

公司簡介



成立時間：2001/4/26

資本額：9.74億元

董事長：劉揚偉

總經理：邱耀銓

營業項目：

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體/工業自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療影像診斷設備製造及設計服務

榮耀與里程碑：

- | | |
|------|-----------------------------------|
| 2001 | 公司設立 |
| 2002 | 通過世界第一大半導體設備製造商之合格供應商認證，開始量產 |
| 2015 | TWSE 掛牌上市 |
| 2020 | 京鼎榮獲SGS 2020 CSR Awards - 菁英獎 |
| 2022 | 榮獲HR Asia所頒發的「2022亞洲企業最佳雇主獎」 |
| 2022 | 榮獲商業週刊評比「碳競爭力100強」 |
| 2023 | 京鼎首本永續報告書榮獲2023 TCSA永續報告書銅獎 |
| 2024 | 榮獲世界第一大半導體設備製造商「2023年度傑出供應商」雙獎項肯定 |

竹南科中廠(HQ)



竹南科研廠



美國矽谷廠



加州

德州

美國矽谷辦公室



上海松江廠



江蘇昆山廠



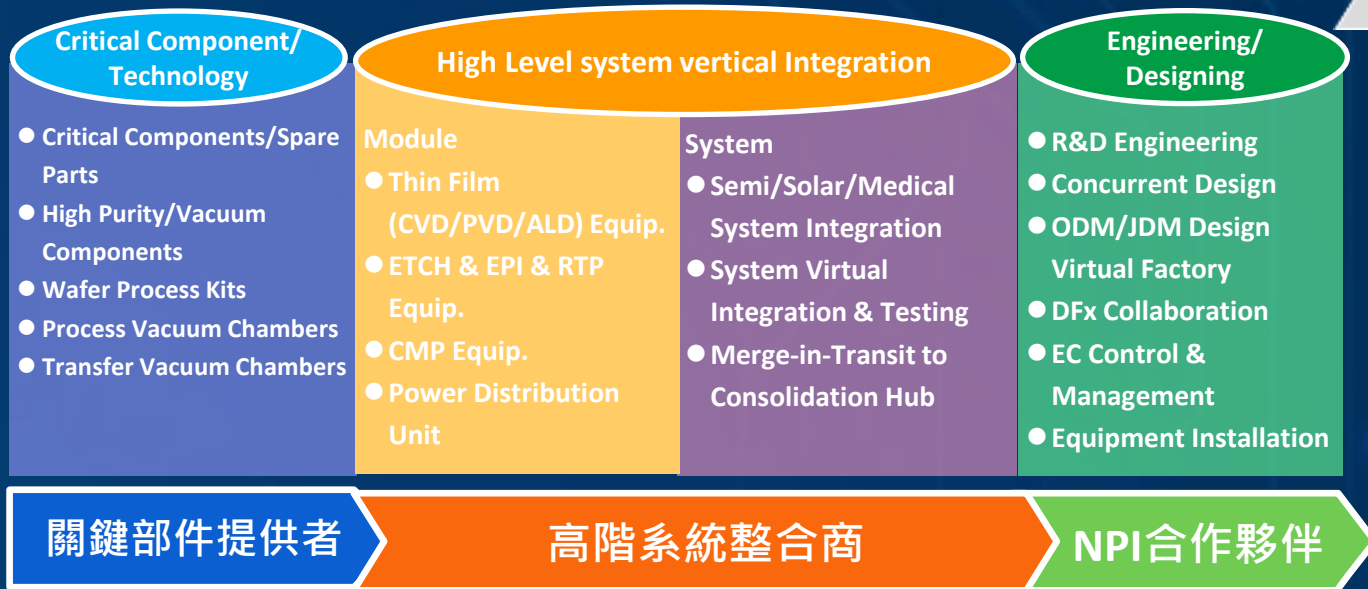
- ：營運製造據點-科中廠/科研廠/松江廠/昆山廠
- ：營運製造據點(新增)-泰國
- ：新產品導入與小量生產據點-矽谷,USA
- ：銷售服務據點-加州/德州/南京

市場定位

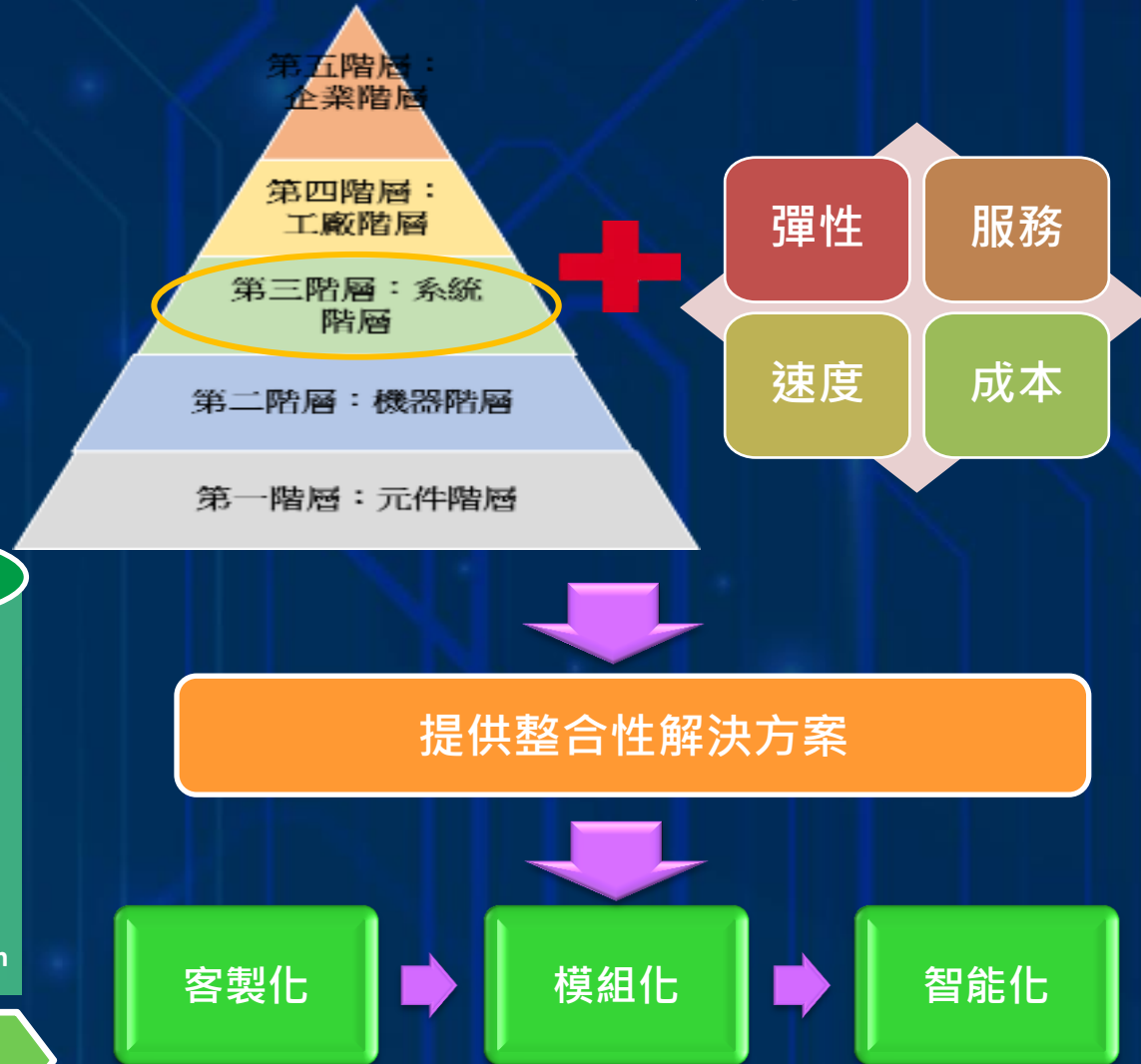
1. 半導體前段製程設備



半導體設備生命週期製造服務



2. 半導體自動化設備



產業/產品佈局



- 半導體晶圓製程設備製造(蝕刻、薄膜、化學機械研磨及檢測設備)
- 能源設備(Solar/LED) 製造
- 關鍵製程備品耗材

半導體製程相關
設備生命週期
製造服務

半導體廠自動化
設備自主研發

- 設備開發(非製程類)
 - 先進製程微污染防治方案
 - 晶圓AOI檢測設備
 - 氮氣倉儲系統
 - 晶圓移載搬送自動化

- 設備再生循環服務
- 零部件再生循環服務
- 技術衍生應用服務

設備及關鍵部件
再生循環經濟

醫療設備開發及
製造服務

- 醫療影像診斷設備
- 醫療設備關鍵零組件
- 放射治療設備

財務報告

綜合損益表



單位：新台幣百萬元	1Q24		4Q23		QoQ%	1Q23		YoY%
營業收入淨額	3,322	100.0%	3,379	100.0%	-1.7%	3,403	100.0%	-2.4%
營業毛利	835	25.1%	927	27.4%	-2.3 pts	891	26.2%	-1.1 pts
營業費用	(353)	(10.6%)	(348)	(10.3%)		(341)	(10.0%)	
營業利益	482	14.5%	579	17.1%	-2.6 pts	550	16.2%	-1.7 pts
營業外損益	263	7.9%	76	2.3%		(9)	(0.3%)	
稅前淨利	745	22.4%	655	19.4%	+3.0 pts	541	15.9%	+6.5 pts
本期淨利	545	16.4%	506	15.0%	+1.5 pts	403	11.8%	+4.6 pts
歸屬予：								
母公司股東	545		506		7.7%	403		35.2%
基本每股盈餘(元)	5.52		5.19		0.33	4.15		1.37
加權平均流通在外股數(百萬股)	98.91		97.33			97.11		

資產負債表及重要財務指標



單位：新台幣百萬元	1Q24		4Q23		1Q23	
現金及流動金融資產	10,921	54%	10,583	55%	9,189	48%
應收帳款	1,122	6%	783	4%	1,075	6%
存貨	2,587	13%	2,620	14%	3,476	18%
長期投資	359	2%	417	2%	550	3%
不動產、廠房及設備	3,994	20%	3,781	20%	3,721	20%
資產總計	20,161	100%	19,370	100%	19,042	100%
應付帳款	1,073	5%	941	5%	963	5%
銀行借款	1,679	8%	1,607	8%	1,735	10%
應付公司債	1,028	5%	1,865	10%	1,854	10%
流動負債	4,798	24%	3,536	18%	6,586	35%
負債總計	8,194	41%	7,768	40%	9,083	48%
股東權益總計	11,967	59%	11,602	60%	9,959	52%
重要財務指標						
平均收現天數	26		25		28	
平均銷貨天數	99		125		135	
平均付現天數	37		45		44	
淨營運現金週期天數	88		105		119	
流動比率(倍)	3.12		4.05		2.12	

現金流量表



單位：新台幣百萬元	1Q24	1Q23
期初現金	6,956	8,544
營運活動之現金(流出)流入	317	(267)
資本支出	(295)	(215)
定期存款	(544)	(22)
銀行借款淨變動	140	(124)
投資與其他	163	(15)
期末現金	6,737	7,901
自由現金流量*	22	(482)

*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

營運與展望

營收趨勢

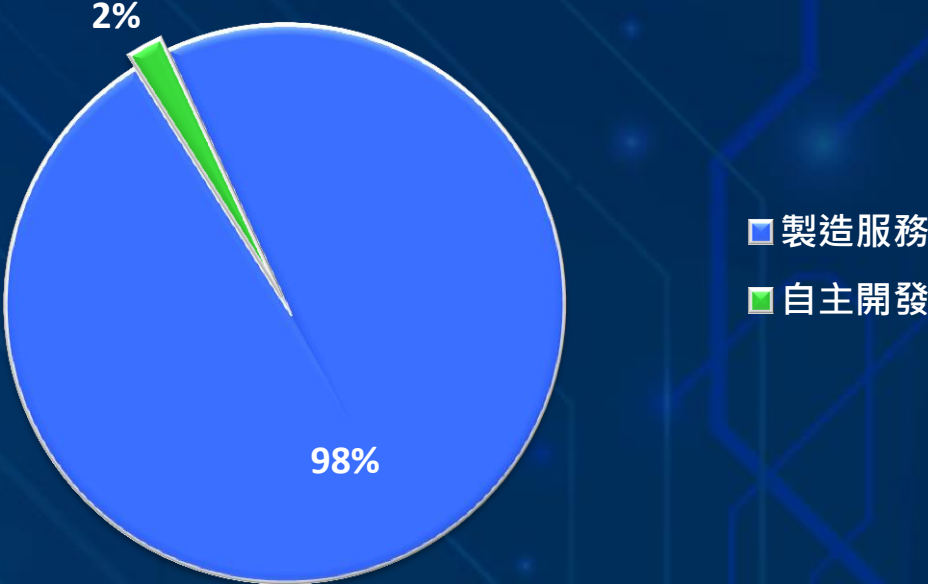


Q1營收**33.22**億 QoQ **-1.7%** YoY **-2.4%**，但仍創同期第三高



註：製造服務=半導體/面板設備關鍵部件製造+能源設備關鍵部件製造；自主開發=自動化設備

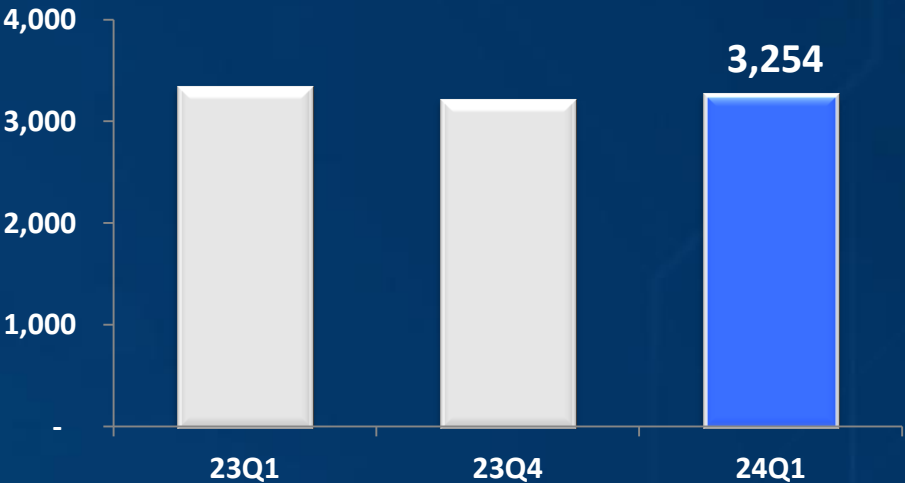
2024年第一季銷售分析-業務別



製造服務

+1.7% QoQ
-2.3% YoY

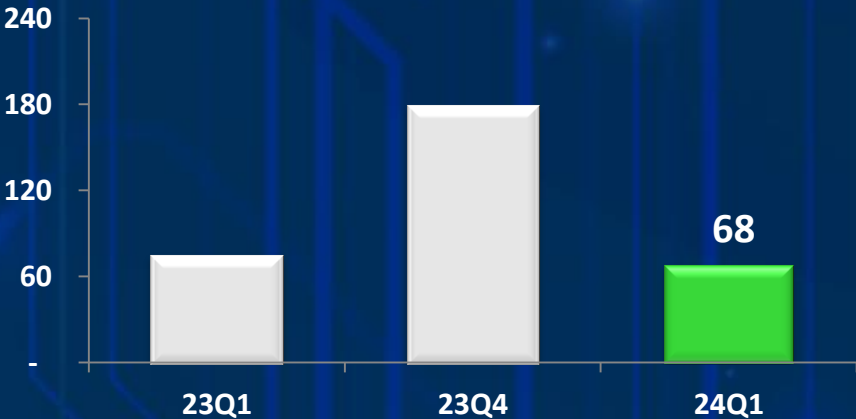
單位：台幣百萬



自主開發

-61.8% QoQ
-7.8% YoY

單位：台幣百萬

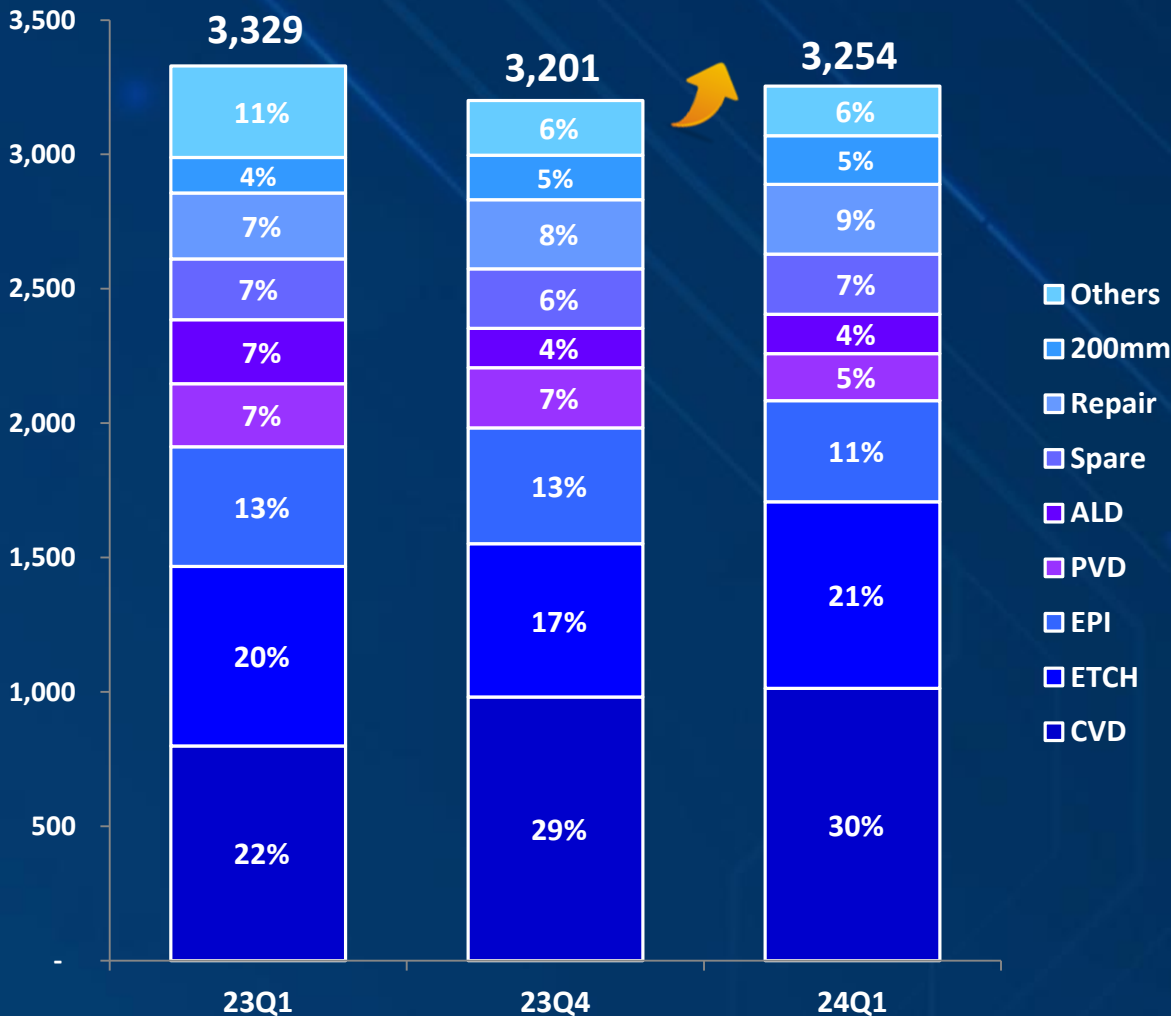


製造服務銷售分析-產品別

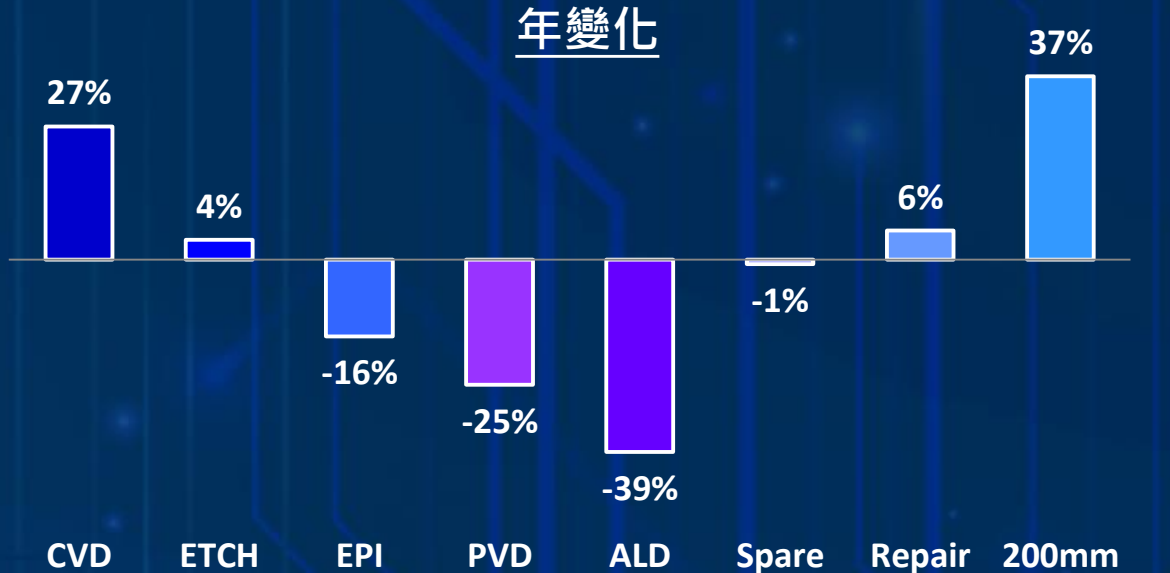
季變化



單位：台幣百萬



年變化

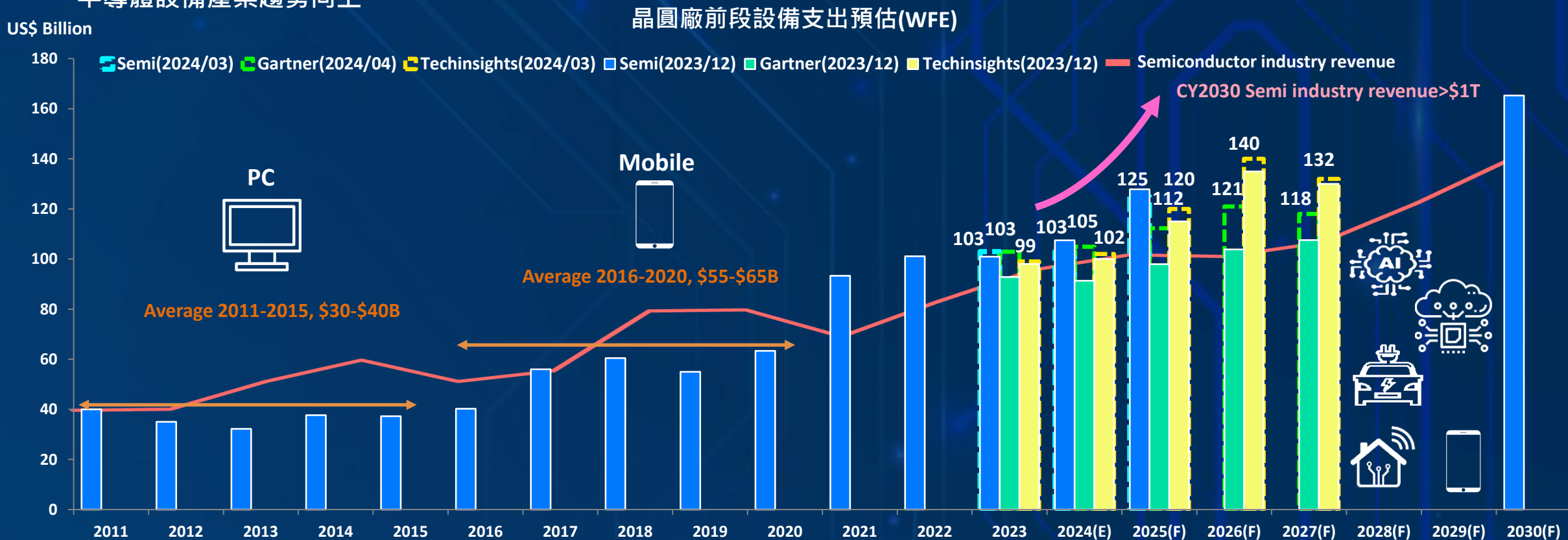


2024年第二季展望



產業趨勢

- 庫存調整至尾聲，終端需求復甦，加上AI、HPC與ICAPS等長期需求支持，各研調機構均預測2024年全球半導體市場將有雙位數的成長(13.1%~20.0%)
- AI和HPC應用驅動高頻寬記憶體(HBM)強勁需求帶動相關領域的投資和產能擴充，調研機構預估2024年半導體設備支出將持平至小幅成長，2025、2026年設備市場需求仍會保持增長趨勢
- 新興科技領域將帶動半導體應用增加、半導體製程技術複雜化、各國建立自主半導體能力與供應鏈和晶圓廠持續戰略性投資，推升半導體設備產業趨勢向上



近期重要事件摘要



- 京鼎公司於5月27日股東會決議配發2023年盈餘之現金股利，總額為新台幣1,173,260仟元，預估每股約新台幣12元
- 泰國土地廠房進行整地興建中
- 京鼎榮獲天下雜誌評選為2024年『2000大企業調查』中，製造業總排名第271名，半導體產業排名第28名

總結



- 預估Q1營收為全年低點，業績可望逐季成長
 - Q1EPS5.52元為同期次高；歸屬母公司淨利、淨利率皆創同期新高
 - 4月營收11.97億元寫下15個月新高，為近10個月來首見年月「雙成長」
- 2024營運將超越半導體設備市場表現
 - 訂單能見度拉長營運動能轉強
 - Q2營收將繳出季增/年增「雙成長」成績單
 - 公司加速佈局中國+1產能來迎接半導體設備市場成長
 - AI趨勢帶動記憶體需求暢旺及晶圓廠產能利用率提升為營運增添成長動能

Q&A



Thank you